

株主懇談会

平成17年9月29日

株式会社 アルバック

◆ 将来見通しに関する記述についての注意事項

このプレゼンテーション資料で述べられている将来の当社に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに作成されたものです。当社グループのお客様であるフラットパネルディスプレイ・半導体・電子部品業界は技術革新のスピードが大変速く、競争の激しい業界です。

また、世界経済、為替レートの変動、フラットパネル・半導体・電子部品の市況、設備投資の動向など、当社グループの業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。したがって、実際の売上高および利益は、このプレゼンテーション資料に記載されている予想数値とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

◆ 本資料における表示方法について

数値： 単位未満四捨五入

比率： 百万円単位で計算後、単位未満四捨五入

▶ **市場環境**

▶ **第102期 (H18/6期) 連結業績予想**

▶ **事業戦略**

事業環境

■ ポジティブ要因

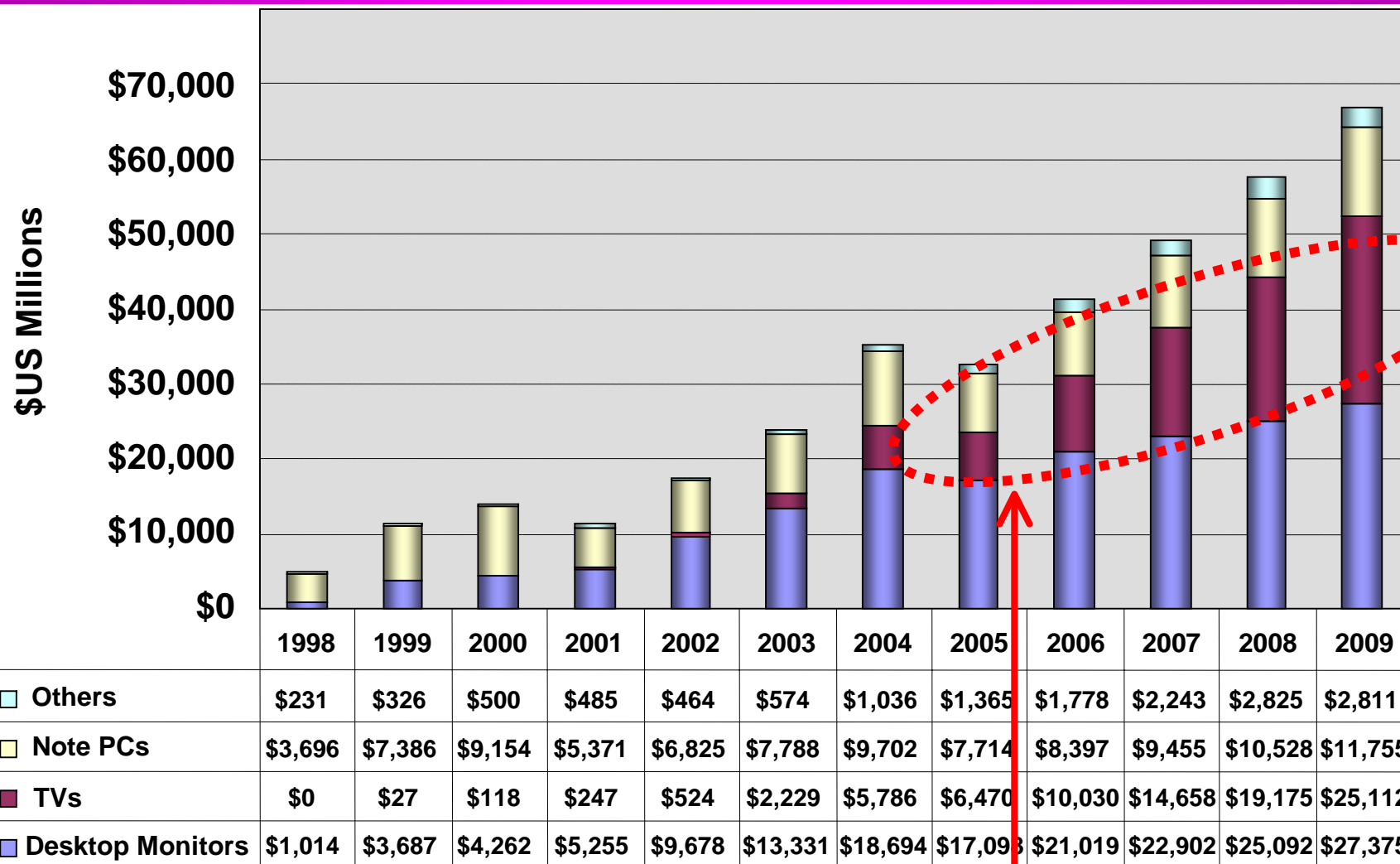
- ▶ FPDやデジタル家電の設備投資は、若干の減速局面があったが、全体的には堅調に推移
- ▶ 化合物半導体、ハイブリッドカーなど新しい分野で成長が開始
- ▶ 基板大型化、新しいデバイスなど新技術の開発が急激に進行
- ▶ 中国の成長が日本や世界経済に大きな影響を与える段階

■ ネガティブ要因

- ▶ 構造的なデフレが益々進行し、市場価格の下落が継続
- ▶ 韓国や中国の装置メーカーがシェアを獲得

グローバルな生き残りをかけた競争が激しさを増す

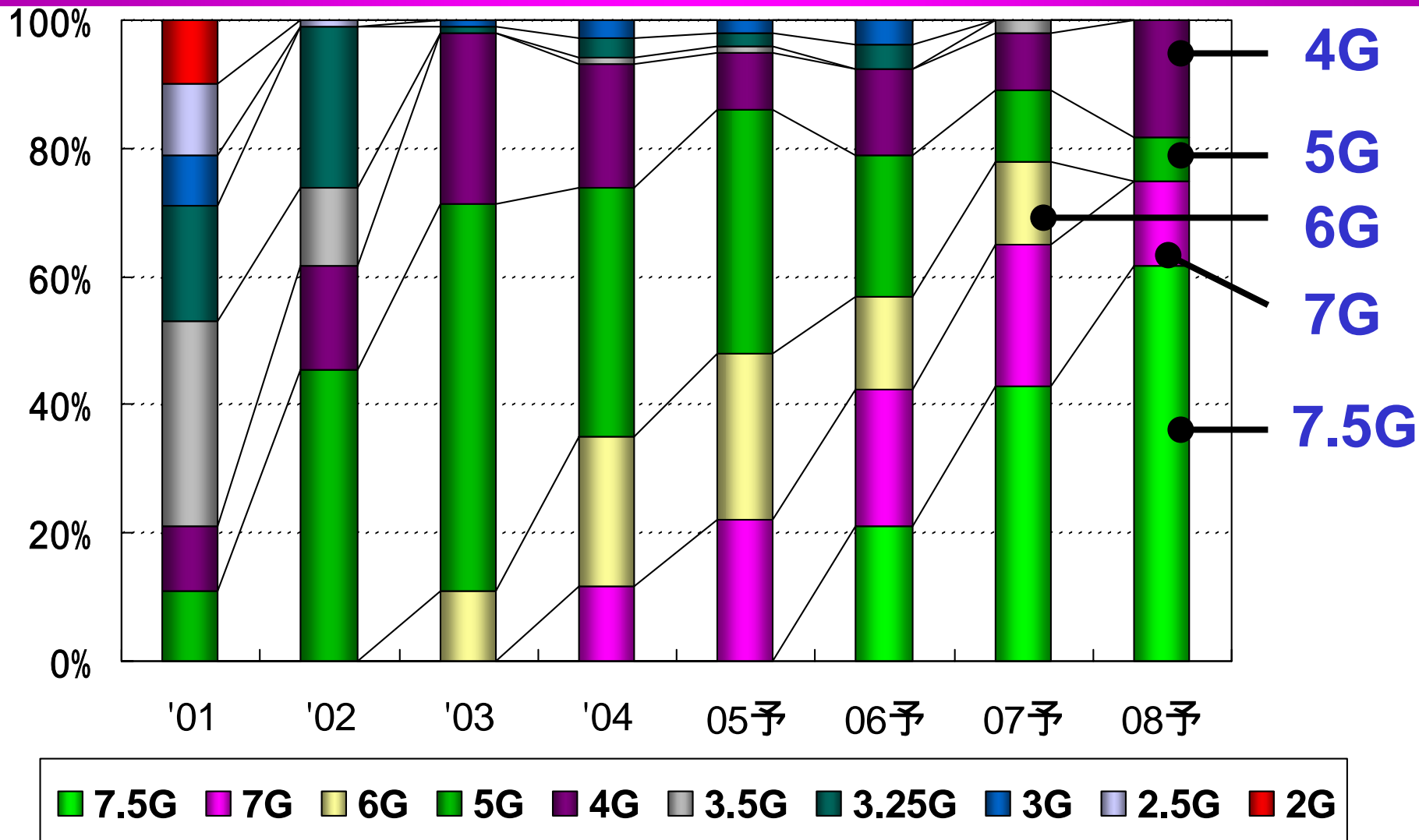
大型TFTLCD用途別市場規模(金額)



(出所:平成17年7月Display Search)

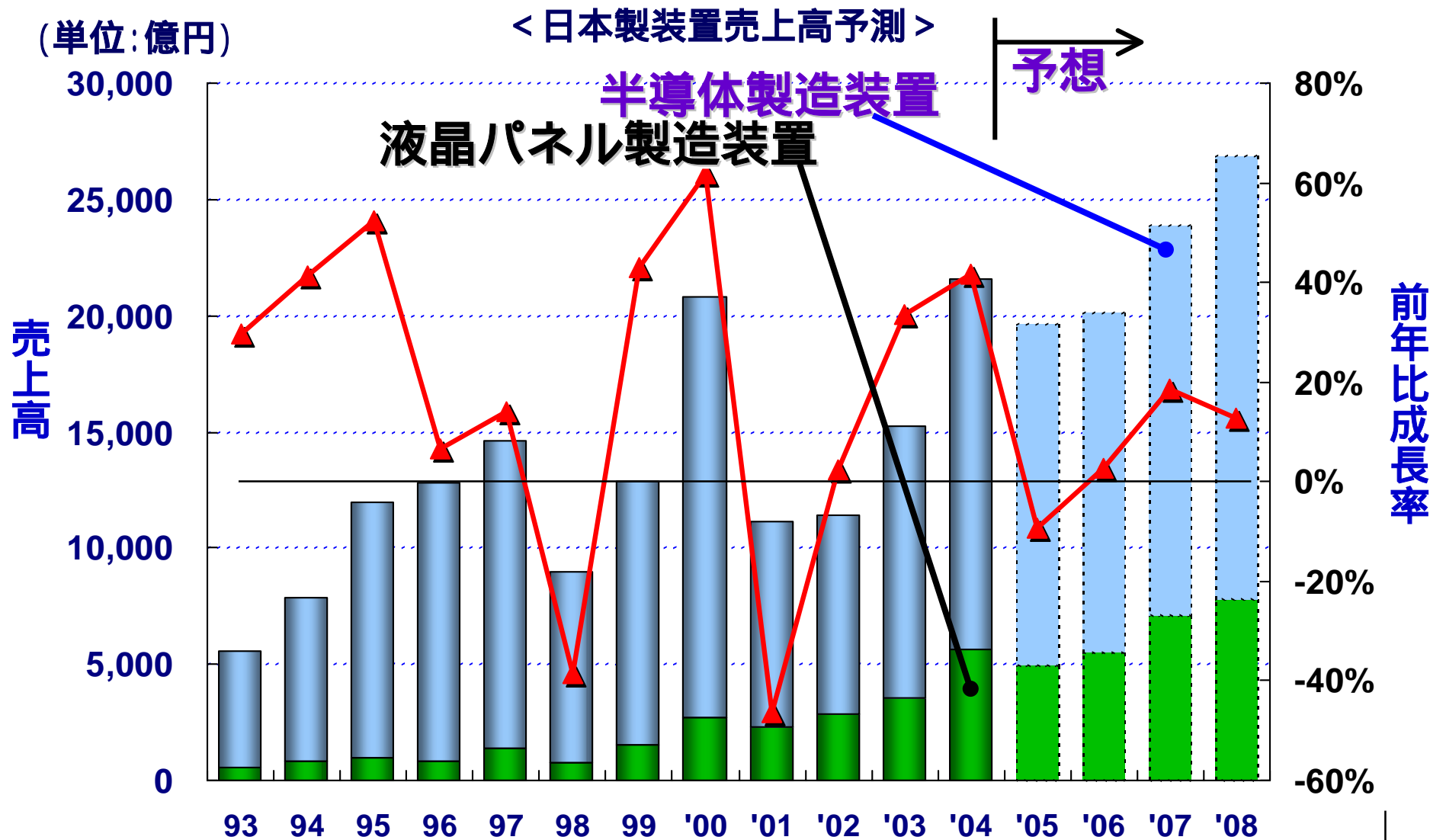
5年間で3.9倍の成長見通し

液晶ディスプレイ世代別投資



(出所:平成17年7月Display Search)

半導体および液晶パネル製造装置予測



(出所:平成17年7月 SEAJ)

(売上高:日系企業(海外拠点含む)の国内および海外への販売高)

▶ 市場環境

▶ **第102期 (H18/6期) 連結業績予想**

▶ 事業戦略

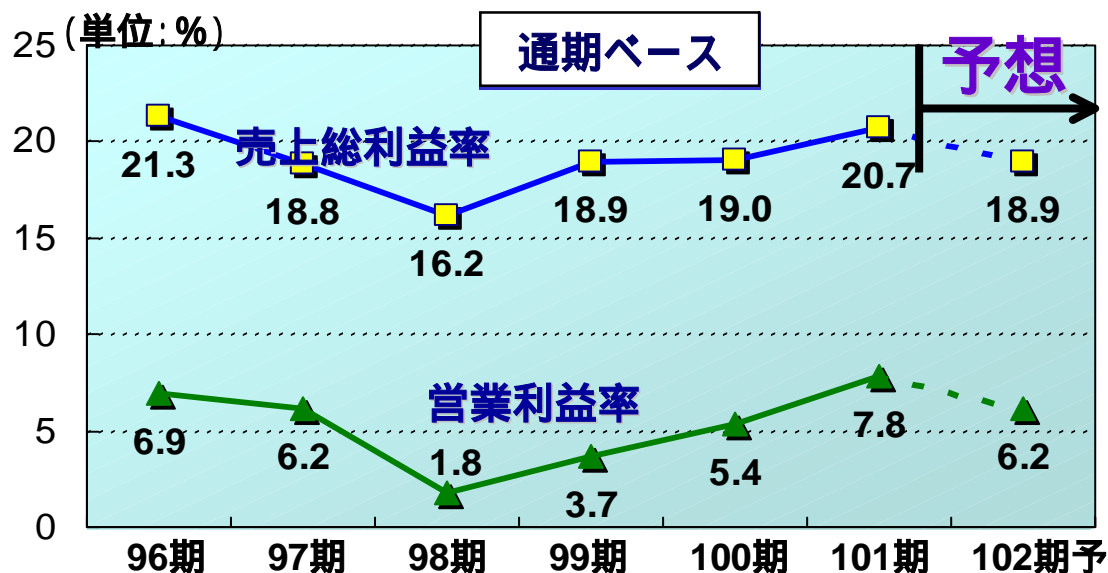
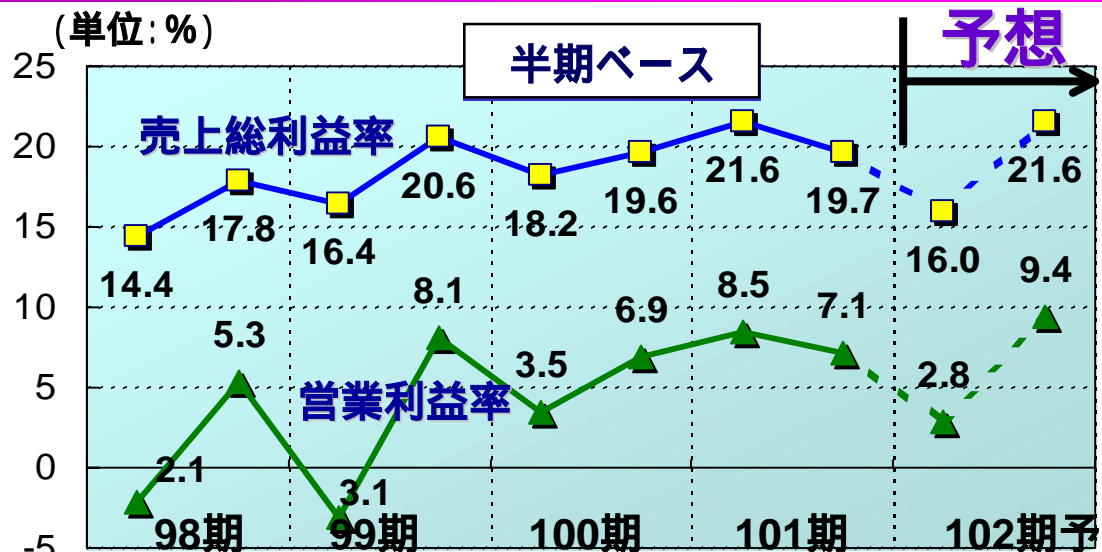
第102期 (H18/6期) 業績予想

(単位: 億円)

	第99期 (H15/6期)	第100期 (H16/6期)	第101期 (H17/6期)	H17/12 (中間)	第102期 (H18/6期)
受注高	1,478 (+37%)	1,782 (+21%)	2,062 (+16%)	1,020 (+4%)	2,100 (+2%)
売上高	1,275 (+1%)	1,579 (+24%)	1,968 (+25%)	1,000 (+7%)	2,100 (+7%)
営業利益	47 (+104%)	85 (+81%)	153 (+81%)	28 (-65%)	131 (-14%)
経常利益	36 (+78%)	73 (+103%)	124 (+71%)	26 (-68%)	126 (+1%)
当期純利益	17 (+143%)	40 (+135%)	71 (+81%)	9 (-83%)	71 (-1%)

【 ()内は増減率、百万円単位で計算後、単位未満四捨五入】

利益率の予想



[小数点以下第2位は四捨五入]

■ 第102期利益率予想

▶ 装置販売価格の下落は5%程度を見込む

▶ 上期

: 6G ~ 7Gのインストールが多く、追加原価発生を見込み、利益率が低下

▶ 下期

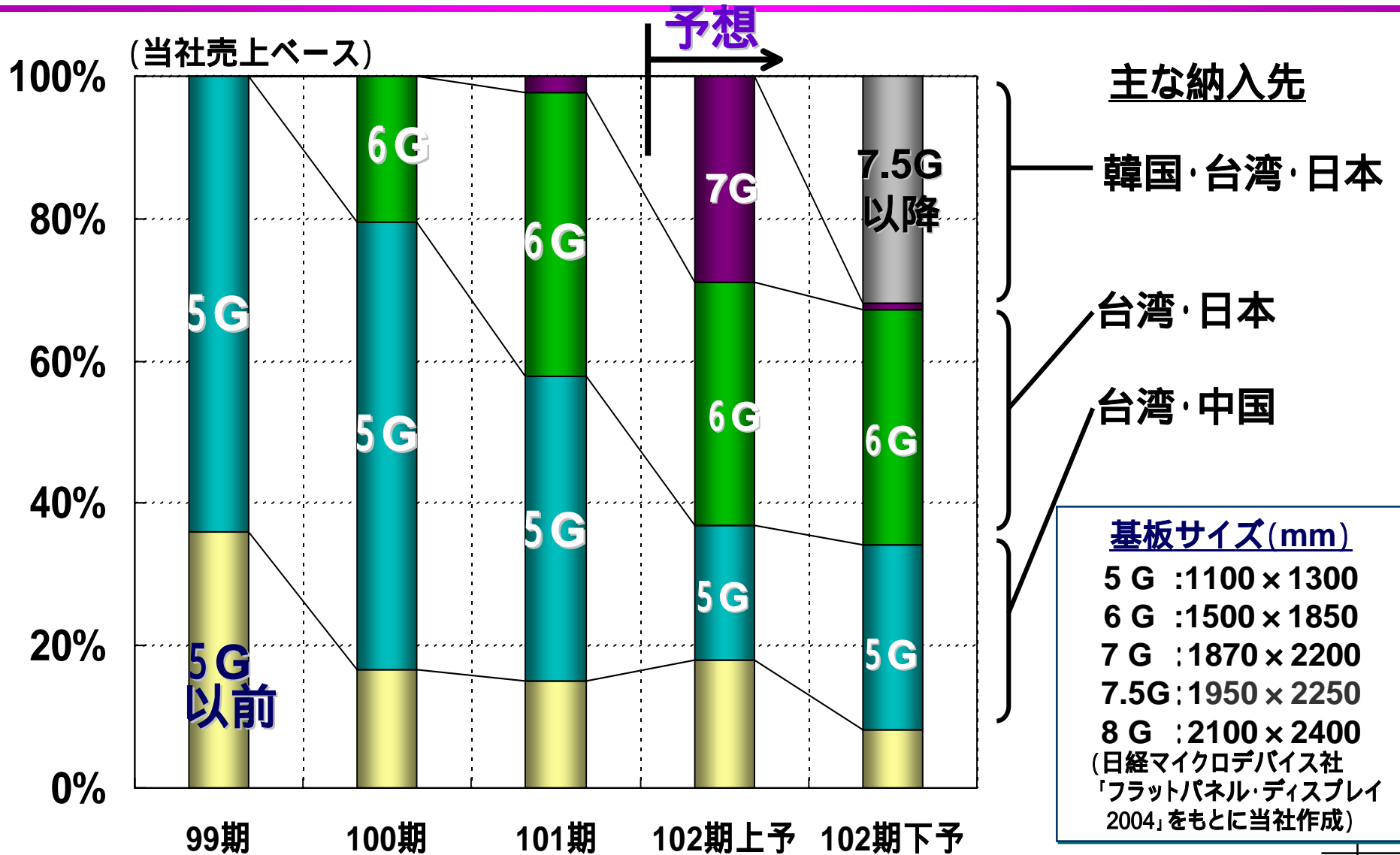
: 5G(中国・台湾) ~ 6Gおよび材料、コンポーネントで利益下支え

: 7G以降(韓国・台湾・日本)で追加原価発生見込む

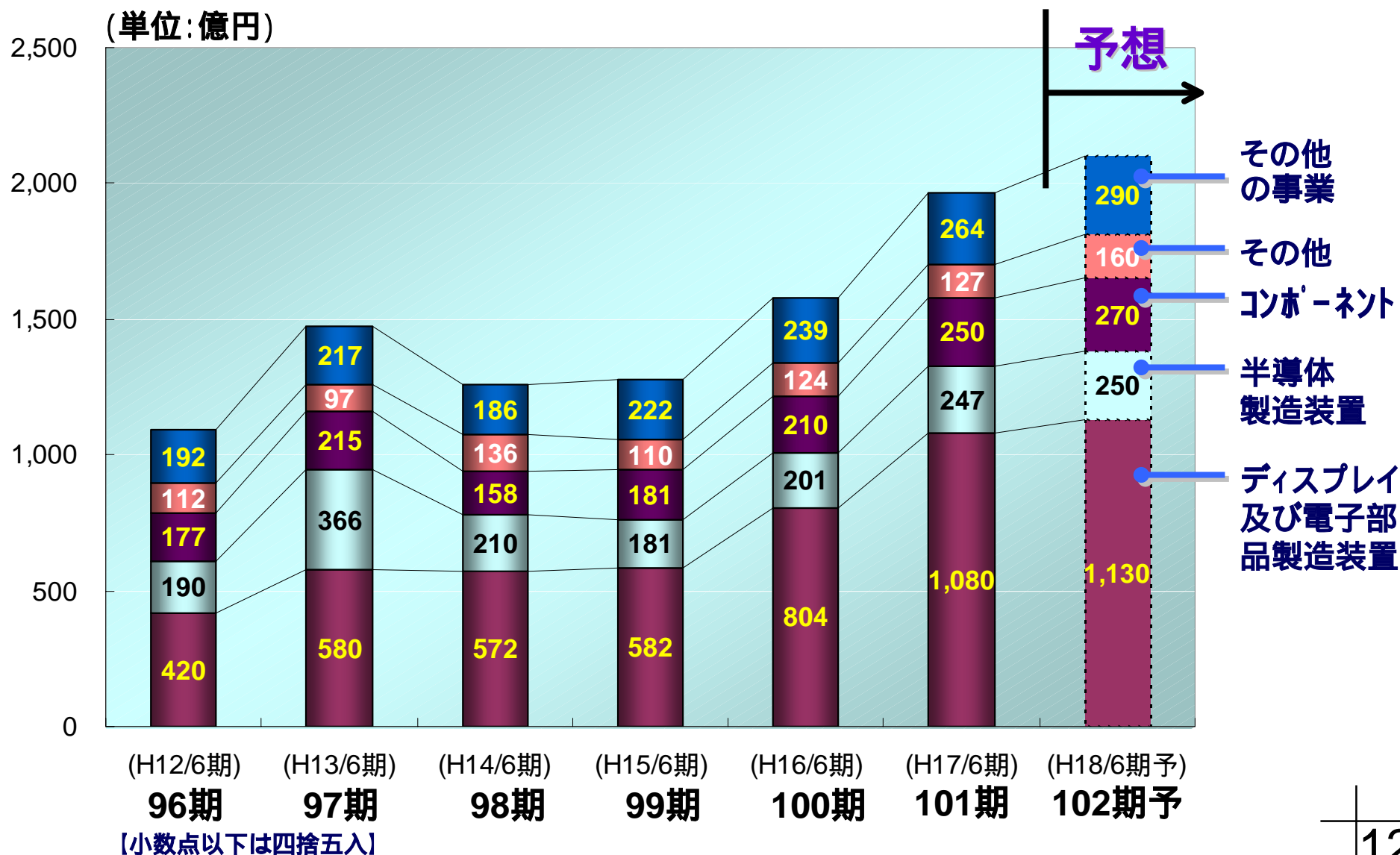
▶ 通期

: コストダウン、標準化と固定費削減を継続し、利益率向上を図る

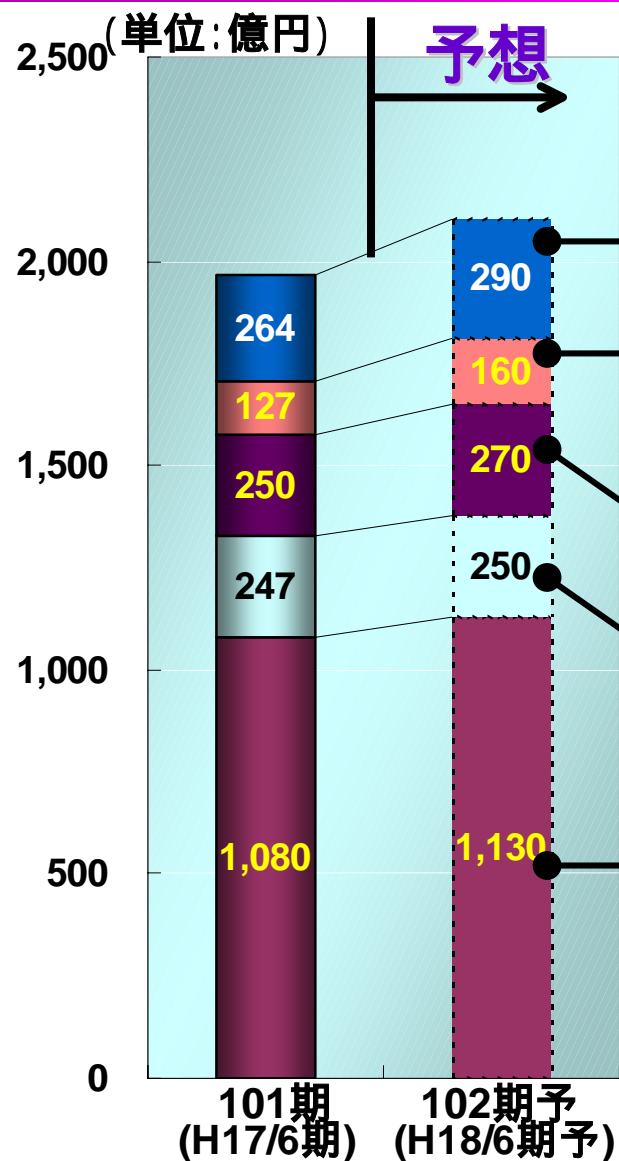
液晶ディスプレイ製造装置の世代の推移



品目別売上高実績・予想



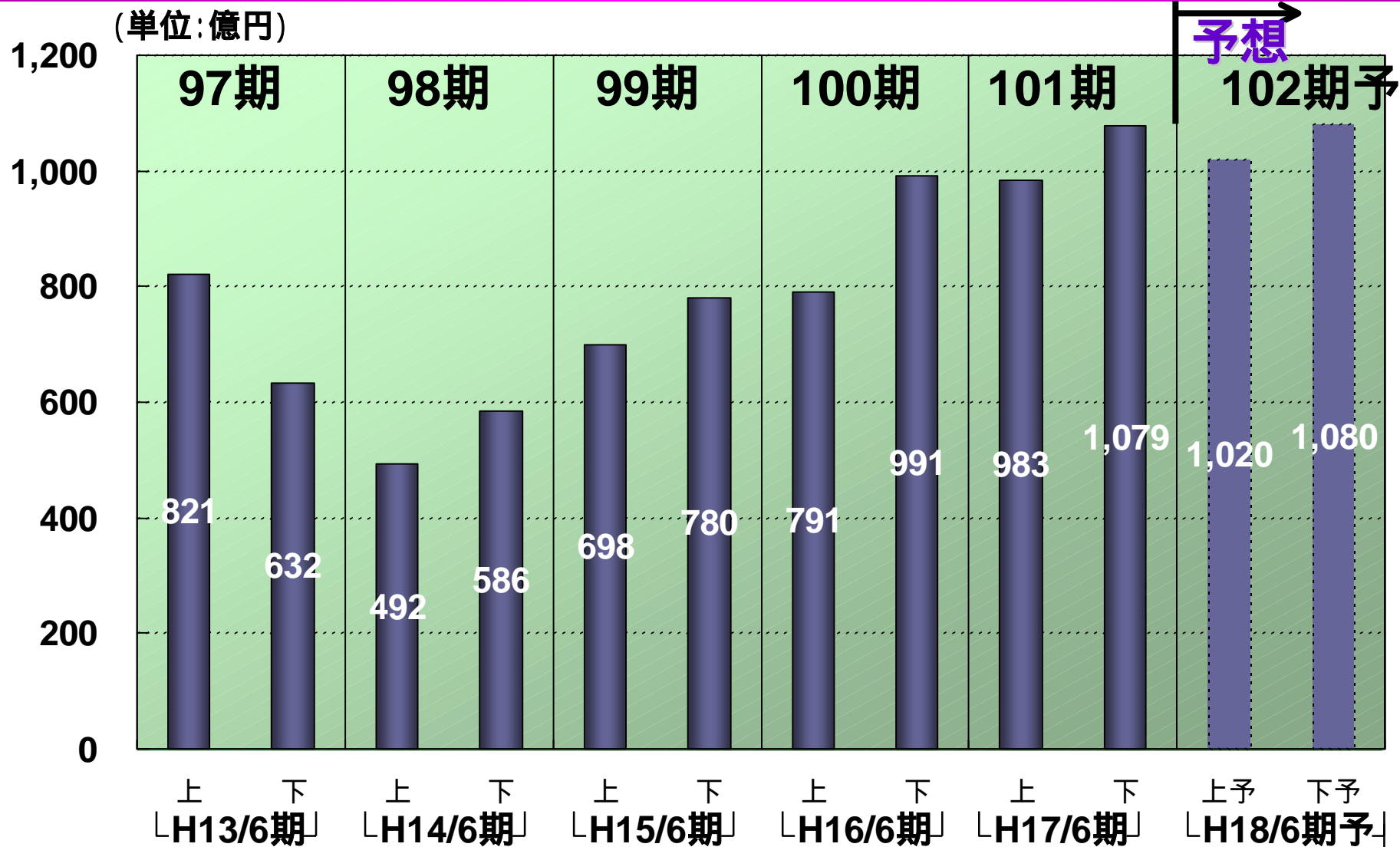
品目別売上高見通し



品目	増減率	主な売上品目
その他の事業	+10%	半導体・液晶用スパッタリングターゲット材、部品洗浄売上続伸
その他	+26%	・コンデンサー用真空蒸着装置 ・自動車関連や中国向け熱処理炉売上拡大
コンポーネント	+8%	・FPD製造装置用ドライポンプ ・自動車、家電、空調関連の真空ポンプ売上続伸
半導体製造装置	+1%	パワーIC、フラッシュメモリ関連スパッタリング、エッチング等微増
ディスプレイおよび電子部品製造装置	+5%	・液晶5G～7.5G以降(スパッタリング、ODF等)は微増 ・次世代ディスプレイ売上拡大 ・電子部品製造装置売上拡大

【記載された金額は四捨五入しておりますので各項目の合計値が一致しない場合があります。】

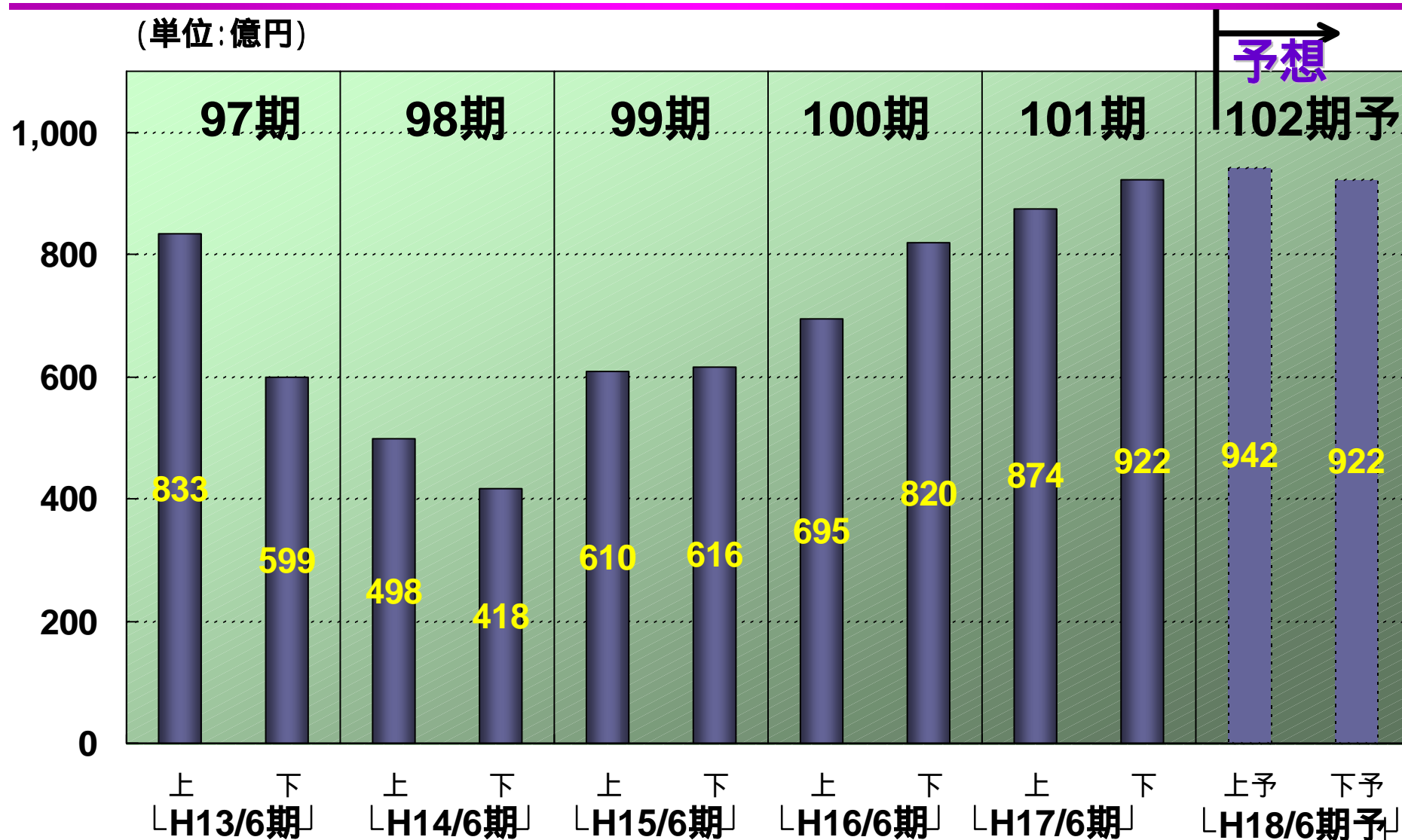
受注高実績・予想



【小数点以下は四捨五入】

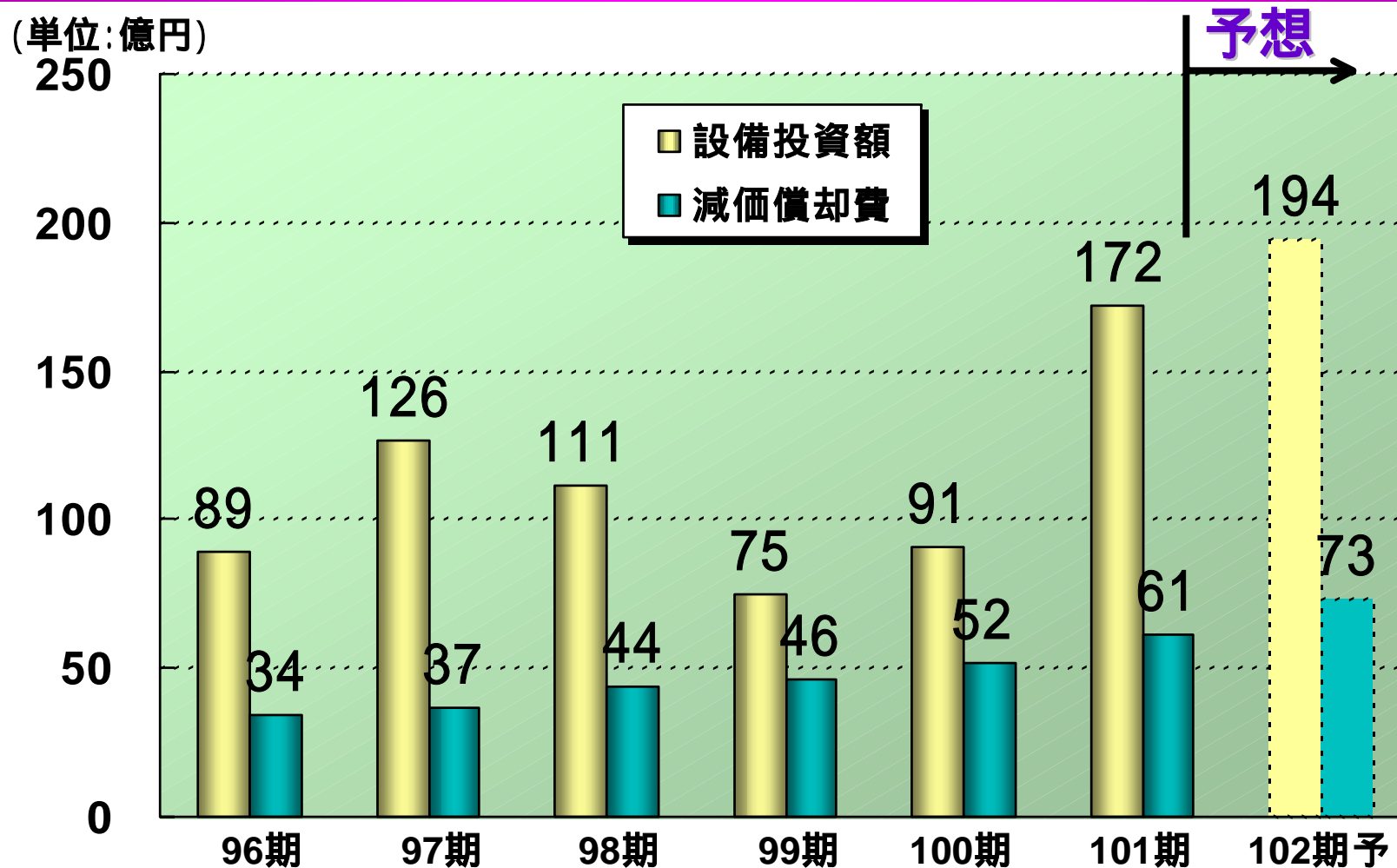
受注残高実績・予想

(単位:億円)



【小数点以下は四捨五入】

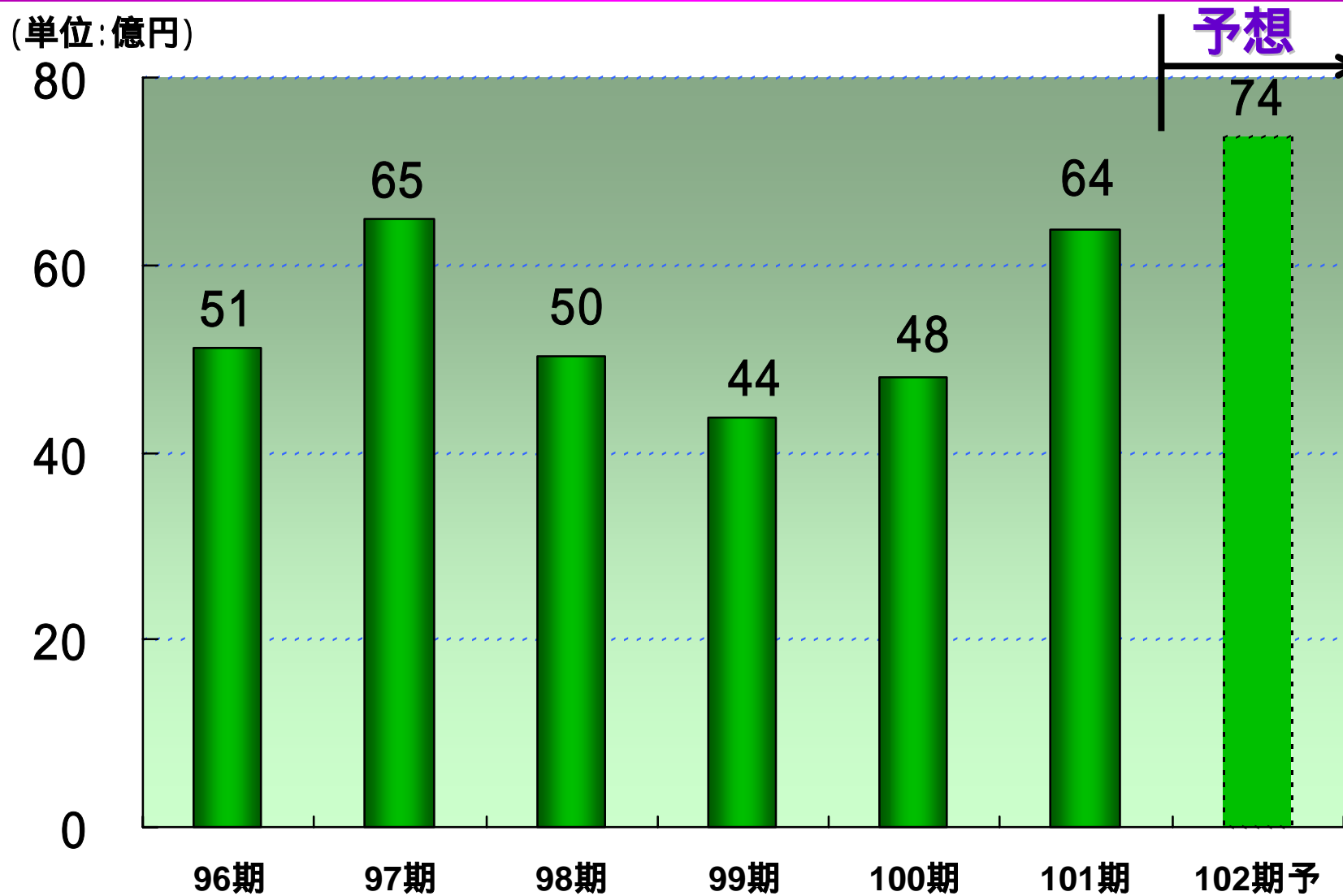
設備投資、減価償却費の推移(連結)



設備投資額	89	126	111	75	91	172	194
減価償却費	34	37	44	46	52	61	73

【小数点以下は四捨五入】

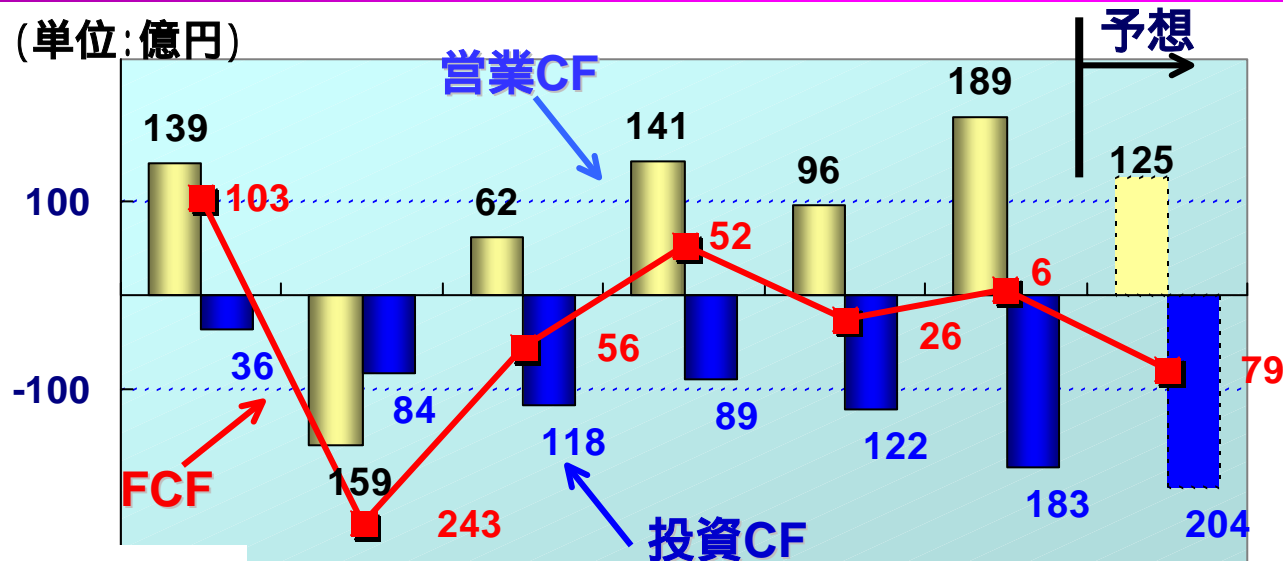
研究開発費の推移(連結)



【小数点以下は四捨五入】

キャッシュ・フローと有利子負債の状況

(単位:億円)



主要要因

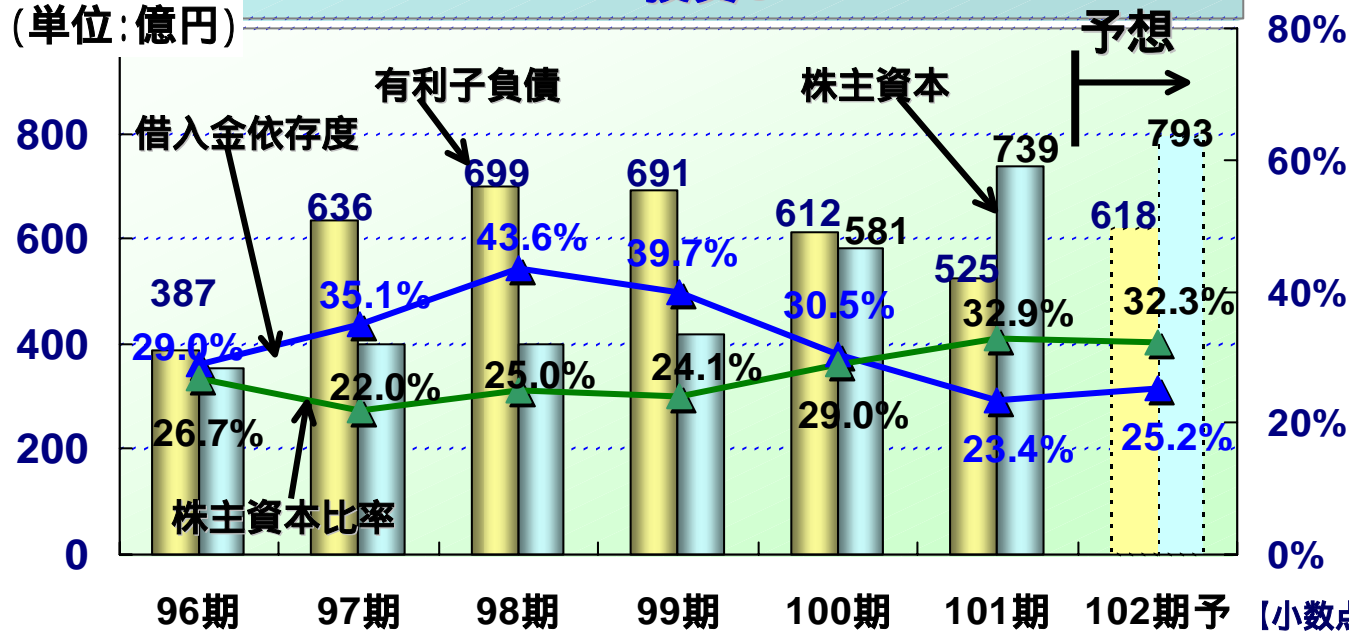
・営業CF: 125億円

下期での売上が多く
予想され売上債権の
増加等が見込まれる
ため

・投資CF: 204億円

中国進出による投資が
増加するため、20億円
増加の予想

(単位:億円)



[小数点以下は四捨五入]

▶ 市場環境

▶ 第102期 (H18/6期) 連結業績予想

▶ **事業戦略**

中長期の事業戦略

■ 中長期戦略

- ▶ FPDやデジタル家電関連分野が周期的な変動をしながら好調を維持すると予想されるものの、液晶ディスプレイの設備投資の成長はいずれ鈍化
- ▶ FPDの次に成長する柱をつくる(ポストFPD戦略)
 1. MEMS、光学膜などのデジタル家電(ハイブリッドモジュール)用装置
 2. エネルギー・環境関連のハイブリッドカー関連装置
 3. 世界の製造業を牽引する中国
 4. 安定経営のためのカスタマーサポートとOEM生産

1.ポストFPD戦略(受注予想)

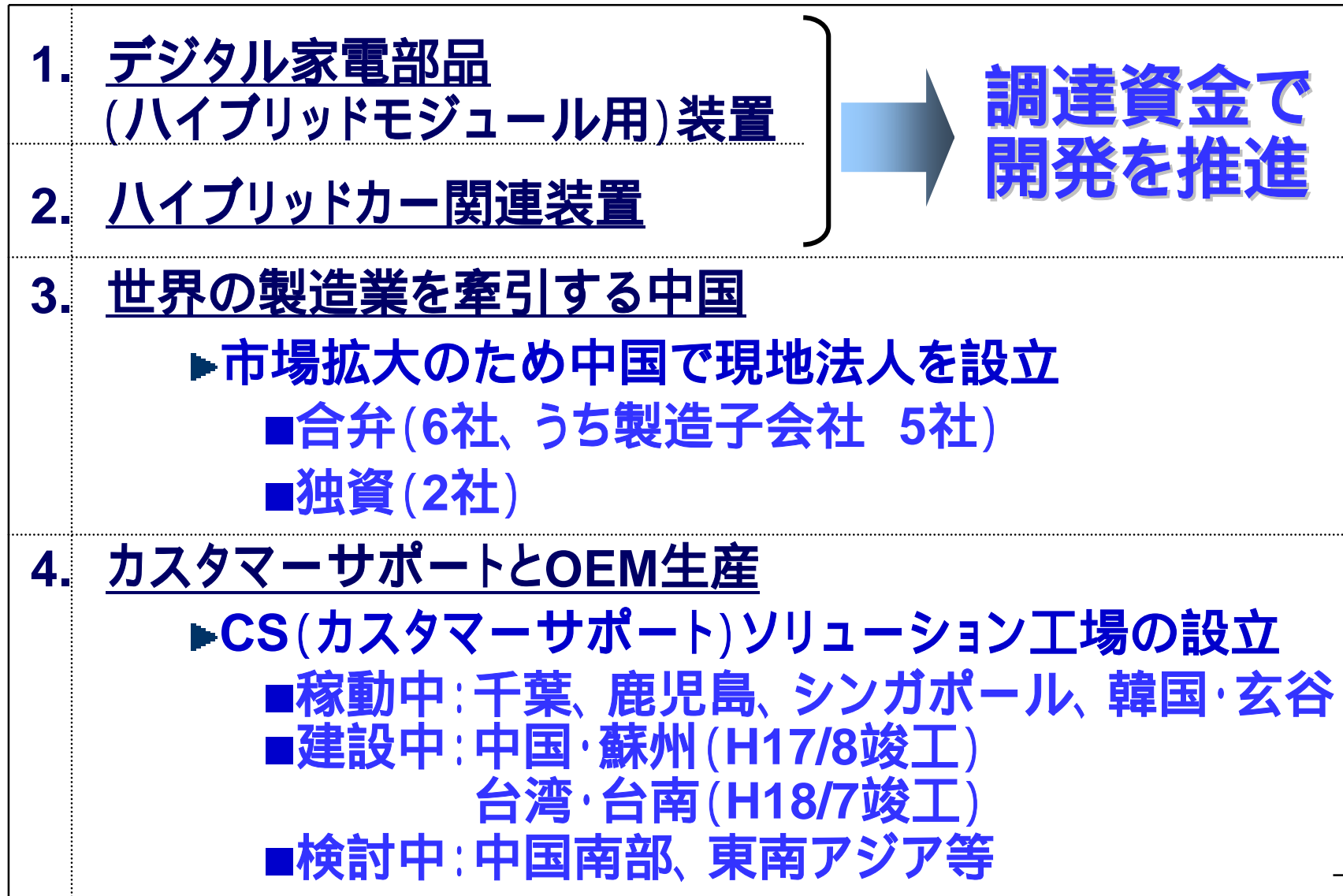
項目と主な分野	H17/6期	H18/6期予	H22/6期予
1.デジタル家電関連 光学膜、化合物半導体 MEMS、高密度実装など	62億円	約110億円	約260億円
2.ハイブリッドカー関連 永久磁石、二次電池 コンデンサー、パワーICなど	37億円	約60億円	約120億円
3.中国市場*1 コンポーネント、一般産業機器 電子機器、FPD・半導体	50億円	約140億円	約520億円
4.CSビジネスとOEM生産 洗浄、部品、材料、サービス 光学膜OEM*2	490億円	約500億円	約900億円

注)*1: H17/6期は非連結の中国現地法人分含まず
H18/6期以降は中国現地法人含む

*2: 非連結

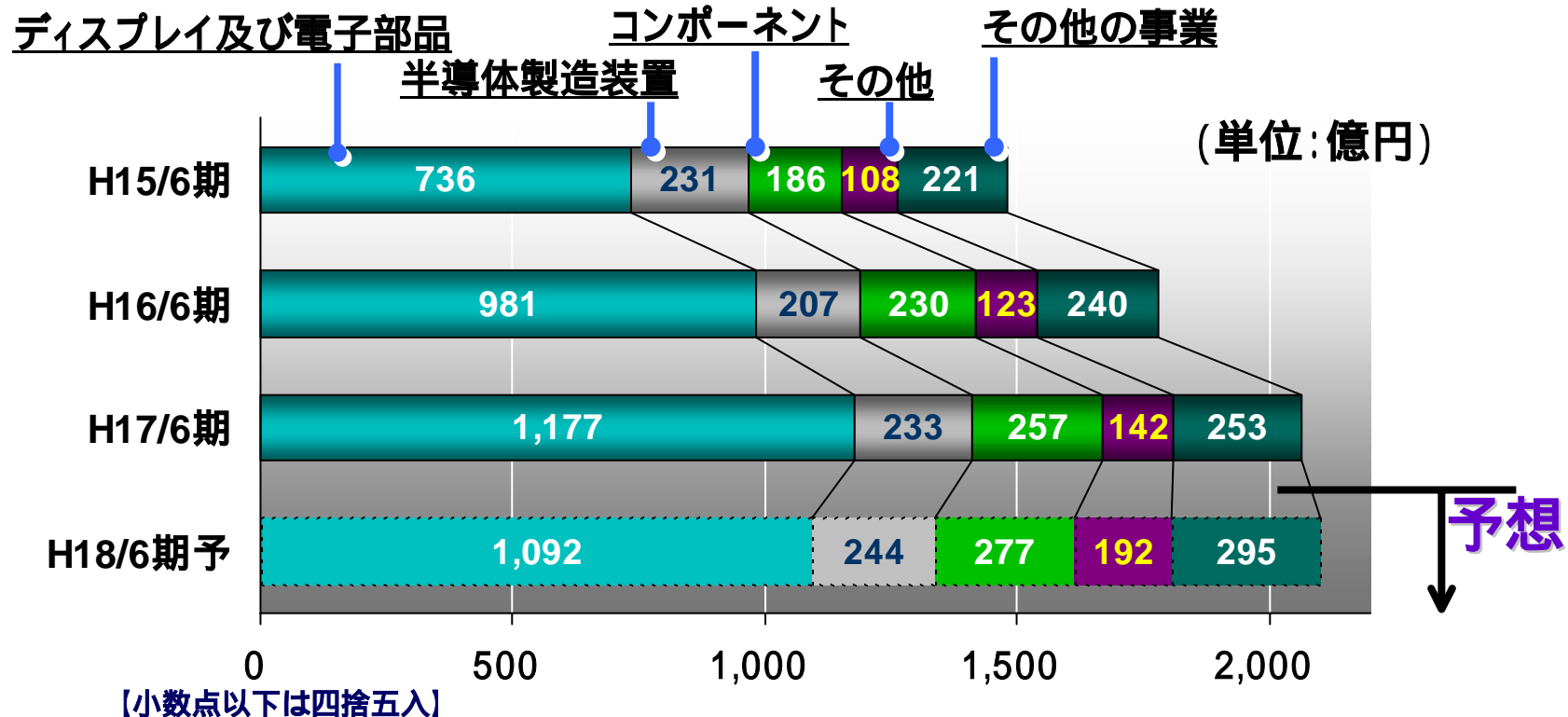
【上記の各項目の予想受注額は一部重複して合算されています。
また、予想受注額は事業規模を判断するための参考値で、当社の連結受注額に合算されない額も含まれています。】

「ポストFPD戦略」成功へのシナリオ



2.受注拡大

H18/6期受注高予想: 2%増



- 既存分野 (FPD、半導体、コンポーネントなど) はラインナップを増やして受注拡大を図る
- 次世代技術、最先端技術の市場で拡販
- アルバックソリューションズで最大限のシナジー効果

3. 今後の新商品開発について

品目	デバイス	主な開発装置	最終製品
ディスプレイ及び電子部品製造装置	液晶ディスプレイ (a-Si TFT, LTPS TFT)	7G以降スパッタリング・プラズマCVD・ ODF・インクジェットプリンティング	薄型TV 
		固体レーザーアニーリング	携帯電話、デジカメ
	プラズマディスプレイ	大型、ハイクト真空蒸着	薄型TV 
	有機EL	高分子:インクジェット装置 低分子:真空蒸着	デジカメ 携帯電話、MP3プレイヤー 
	光学膜	多層膜光学膜スパッタリング	薄型TV、デジカメ 
半導体製造装置	デジタル家電関連 デバイス	真空蒸着、スパッタリング、エッチング スパッタリング、エッチング	LED デジカメ、フラッシュメモリ
	化合物半導体 MEMS	深堀エッチング ハイブリッドモジュールエッチング	レーザーダイオード バイオ 
	パワーIC	極薄ウエーハ用イオン注入・スパッタリング	ハイブリッドカー 
コンポーネント		大型ドライポンプ、表面形状測定器	薄型TV
その他	強磁性体磁石	真空熱処理、真空溶解炉	ハイブリッドカー
	コンデンサー	巻取式真空蒸着装置	

4.主な今後の投資予定

■台湾新会社設立(台南工場)

▶液晶ディスプレイ製造装置会社

◆資本金 15億円

◆事業目的

大型液晶ディスプレイ製造装置生産

▶カスタマーサポート会社

◆資本金 10億円

◆事業目的

装置部品製作

部品表面処理(洗浄)

真空装置ユニット製作など

▶敷地面積 約9,700坪

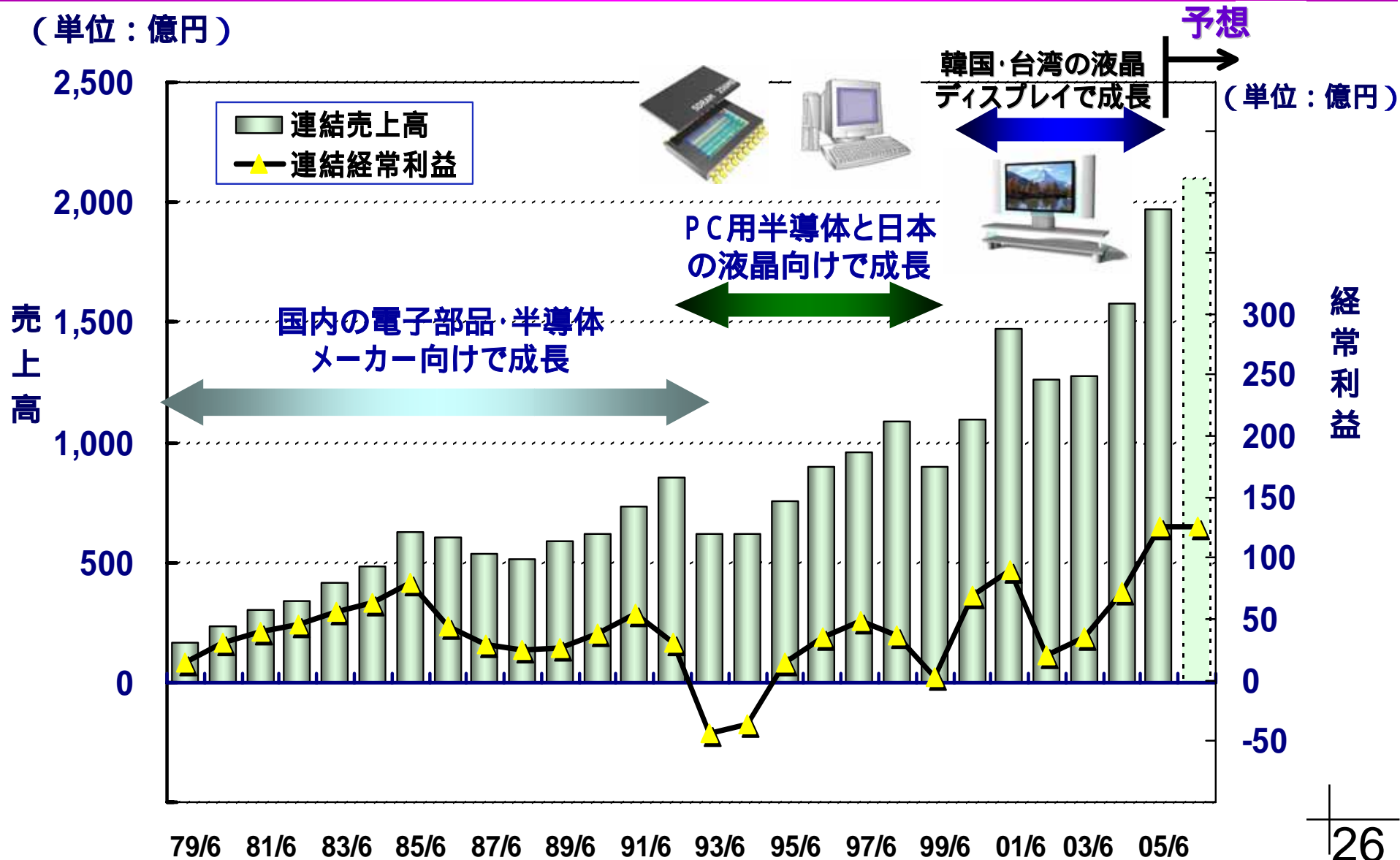
▶竣工予定 平成18年7月～19年1月

▶設立場所 台南科学工業園区内



投資提携調印式(平成17年8月8日)

5.売上高・経常利益の推移



ULVAC

本日は
ありがとうございました